

SEMICON[®] JAPAN

SEMICON JAPAN 2019 参加報告書

群馬大学理工学府

電子情報・数理教育プログラム

小林研究室 修士2年 張鵬飛

1. イベント概要

SEMICON Japan は、半導体の前工程～後工程までの全工程から、自動車や IoT 機器などの SMART アプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会です。

<https://www.semiconjapan.org/jp/>

2. 開催期間

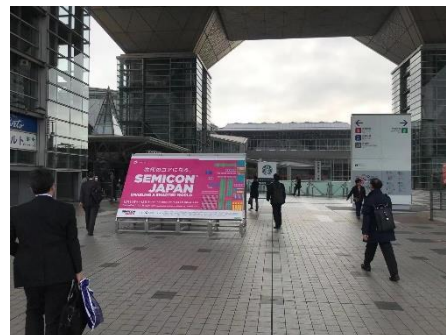
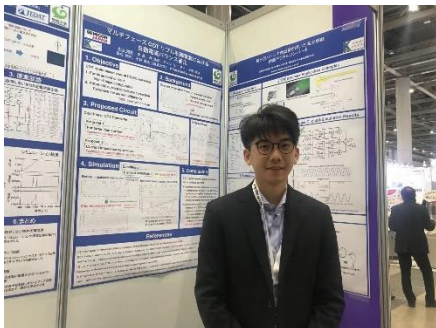
2019 年 12 月 11 日(水)–13 日(金) 3 日間共通 10:00–17:00

3. 開催場所

東京ビッグサイト 西展示棟・南展示棟・会議棟

4. 参加報告

私は群馬大学小林研究室のブースで説明者として参加し、自身の研究のポスター発表を行った。会場には学生の展示エリアが設けてあり、大学や高専から多くの出展があった。また「未来 COLLEGE」という学生向けに企業の方々から会社説明をして頂けるブースがあり、半導体を扱う企業の説明をたくさん聞き、それぞれの企業の特色や最近の半導体事情などを知ることができた。



5. 謝辞

SEMICON JAPAN 2019 参加の機会を与えて頂いた小林春夫先生、参加にあたり様々なサポートをして頂いた桑名杏奈先生、小林春夫研究室ブースにお立ち寄り頂いた皆様に深くお礼申し上げます。

